



2021年9月1日

各位

会社名 株式会社ディー・ディー・エス  
代表者 代表取締役会長 三吉野 健滋  
(東証マザーズ・コード番号 3782)  
問合せ先 経営管理部 部長 小野寺 光広  
電話番号 052-955-5720  
(URL <https://www.dds.co.jp/ja/>)

### 汗孔と隆線を使った認証アルゴリズムに関する新特許取得のお知らせ

指紋認証を始めとした様々なセキュリティ・ソリューションを提供する株式会社ディー・ディー・エス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：久保 統義、以下 DDS）は、汗孔と隆線を使った認証アルゴリズムに関する特許を取得しましたので、お知らせいたします。

【発明の名称】 認証情報処理プログラム及び認証情報処理装置

【特許番号】 特許第6927534号

【特許権者】 株式会社ディー・ディー・エス

【出願番号】 特願2019-517534

【出願日】 2018年4月18日

【登録日】 2021年8月10日

本特許は、2021年6月2日に適時開示いたしました新特許であります汗孔（かんこう）(\*1)などの指紋隆線の微細構造を解析することで認証を行う高精度の認証アルゴリズムについて、照合の原理を示したものです。

#### ◆用語の解説

\*1 汗孔（かんこう）：汗が排出される出口のこと。

当社は汗孔と隆線を使った認証アルゴリズムに関する5件の特許申請を行っていましたが、本件が権利化され、申請しておりました全ての特許が権利化されました。

<参考>

出願日	出願番号	発明名称	登録日	登録番号
2016/10/31 2017/11/16	特願 2016-213898 PCT/JP2017/039416 特願 2018-547231	皮膚情報処理プログラム及び 皮膚情報処理装置	JP:2020/6/26 US:2020/8/11 KR:2021/3/5	特許第 6723547 号 US 10,740,590 B2 第 10-2226583 号
2016/10/31 2017/11/16	特願 2016-213899 PCT/JP2017/039417 特願 2018-547232	皮膚情報処理プログラム及び 皮膚情報処理装置	JP:2020/6/26 US:2020/8/11 KR:2021/3/8	特許第 6723548 号 US 10,740,589 B2 第 10-2227319 号
2017/5/9 2018/4/18	特願 2017-093166 PCT/JP2018/15999 特願 2019-517533	認証情報処理プログラム及び 認証情報処理装置	JP:2021/5/7	特許第 6879524 号
2017/5/9 2018/4/18	特願 2017-093172 PCT/JP2018/16002 特願 2019-517535	認証情報処理プログラム及び 認証情報処理装置	JP:2021/6/7	特許第 6894102 号
2017/5/9 2018/4/18	特願 2017-093169 PCT/JP2018/16000 特願 2019-517534	認証情報処理プログラム及び 認証情報処理装置	JP:2021/8/10	特許第 6927534 号

なお、当発表においてDDSの2021年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上